

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成26年6月5日(2014.6.5)

【公開番号】特開2013-12561(P2013-12561A)

【公開日】平成25年1月17日(2013.1.17)

【年通号数】公開・登録公報2013-003

【出願番号】特願2011-143739(P2011-143739)

【国際特許分類】

H 01 G 4/232 (2006.01)

H 01 G 4/30 (2006.01)

H 01 G 4/252 (2006.01)

【F I】

H 01 G 4/12 3 5 2

H 01 G 4/30 3 0 1 B

H 01 G 1/14 V

【手続補正書】

【提出日】平成26年4月21日(2014.4.21)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

主要な表面と、主要な裏面と、2つの端面と、2つの側面を有する略直方体のセラミック素体の両端面に、前記端面を覆う端面部分と前記主要な表面、前記主要な裏面および前記2つの側面に回り込んで形成された回り込み部分とを有する端子電極を備えた積層セラミック電子部品であって、前記端子電極は、前記端面部分及び前記回り込み部分に凹部が形成されており、前記端面部分の凹部の幅W1は前記素体の幅W0の30%以上であり、かつ、前記凹部の深さt1は前記端面部分の最大厚さtmax1の10ないし50%であり、前記回り込み部分の凹部の幅L1は前記回り込み部分の長さL0の30%以上であり、かつ、前記回り込み部分の凹部の深さt2は前記回り込み部分の最大厚さtmax2の10ないし40%であることを特徴とする積層セラミック電子部品。

【請求項2】

前記端子電極がディップ塗布法によって形成されたことを特徴とする請求項1に記載の積層セラミック電子部品。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0012】

主要な表面と、主要な裏面と、2つの端面と、2つの側面を有する略直方体のセラミック素体の両端面に、前記端面を覆う端面部分と前記主要な表面、前記主要な裏面および前記2つの側面に回り込んで形成された回り込み部分とを有する端子電極を備えた積層セラミック電子部品であって、前記端子電極は、前記端面部分及び前記回り込み部分に凹部が形成されており、前記端面部分の凹部の幅W1は前記素体の幅W0の30%以上であり、かつ、前記凹部の深さt1は前記端面部分の最大厚さtmax1の10ないし50%であ

り、前記回り込み部分の凹部の幅 L_1 は前記回り込み部分の長さ L_0 の 30 % 以上であり、かつ、前記回り込み部分の凹部の深さ t_2 は前記回り込み部分の最大厚さ t_{max} の 10ないし 40 % であることを特徴とする積層セラミック電子部品によって達成される。